

HX-331 SMT无铅高温锡膏

产品名称	HX-331 SMT无铅高温锡膏
公司名称	深圳市华茂翔电子有限公司
价格	100.00/瓶
规格参数	品牌:华茂翔 型号:HX-331
公司地址	深圳市宝安区西乡 三围宝安大道5001号沙边工业区A栋4楼B
联系电话	0755 - 29181122 13631672718

产品详情

产品简介

HX331本公司生产的一款无铅免清洗锡膏，使用锡银铜（Sn96.5Ag3Cu0.5）无铅高银合金焊粉及特殊溶剂，适合于要求较高温度以及优良润湿性的焊接工艺。本品印刷性能一致、重复性好，在模板上的保质期长，适合目前的高速生产和高精密度表面贴装生产线上使用，如手机、电脑、MID等。这种焊膏在无铅金属化表面上的湿润性极好，可靠性高。

优点

- A. 使用无铅Sn96.5Ag3Cu0.5高银含量锡粉，适用于焊接要求高的精密器件以及难以上锡器件的贴装焊接。
- B. 在各类型元件上均有良好的可焊性，优良的润湿性，且BGA空洞率低。
- C. 热塌性好，无锡珠、连锡焊接缺陷，残留物极少且呈透明状，免清洗。
- D. 在连续印刷及叉型模式中可获得绝佳的印刷效果。
- E. 在精密PCB板组装时，4-6#粉（5-38mm）可以满足0.3mm间距以下的印刷及焊接要求。

产品特色

- 1. 本产品为无卤素免洗型，回流焊后残留物极少，无需清洗即可达到优越的ICT探针测试性能，具有极高之表面绝缘阻抗。

- 2、在许可范围内，连续印刷稳定，在长时间印刷后仍可与初期之印刷效果一致，不会产生微小锡球。
- 3、印刷时具有优异的脱膜性，可适用于细间距器件【0.4mm/16mil-0.3mm/12mil】贴装。
- 4、溶剂挥发慢，可长时间印刷不会影响锡膏的粘度。
- 5、触变性佳，印刷中和印刷后不易坍塌，可减少焊接架桥之发生。
- 6、回流焊时具有极佳的润湿性能，焊后残留物腐蚀性小。
- 7、回流焊时产生的锡球极少，有效的避免短路之发生。
- 8、焊后焊点饱满良好，强度高，导电性极佳。
- 10、产品储存性佳，可在0-10℃密封保存6个月，室温25℃密封可保存一周。
- 11、适用的回流焊方式：对流式、传导式、热风式、镭射式、气相式、红外线。

产品保存

- 1.新鲜锡膏的储存：0-10℃，密封储存，温度过高会相应缩短其使用寿命，影响其特性；温度太低（低于-5℃）可能会产生结晶现象，使特性恶化；在正常储存条件下，有效期为6个月。
- 2.开封后锡膏的储存：购买后应放入冷库或冰箱中保存，采用先进先出的原则使用。使用后的锡膏若无污染，必须密封冷存，开封后的锡膏保存期限为一星期，超过保存期限请做报废处理，以确保生产品质。
- 3.产线使用锡膏，用完后请立即盖上内外盖，如若一直为开罐状态，下班时请检查锡膏状态，如果粘性明显变大请报废处理。

包装方式

- 1.包装以罐装和针筒为1个单位，每罐500克，每支30克或100克，针筒和罐子为聚乙烯制成，颜色为白色，盖子分内、外盖。